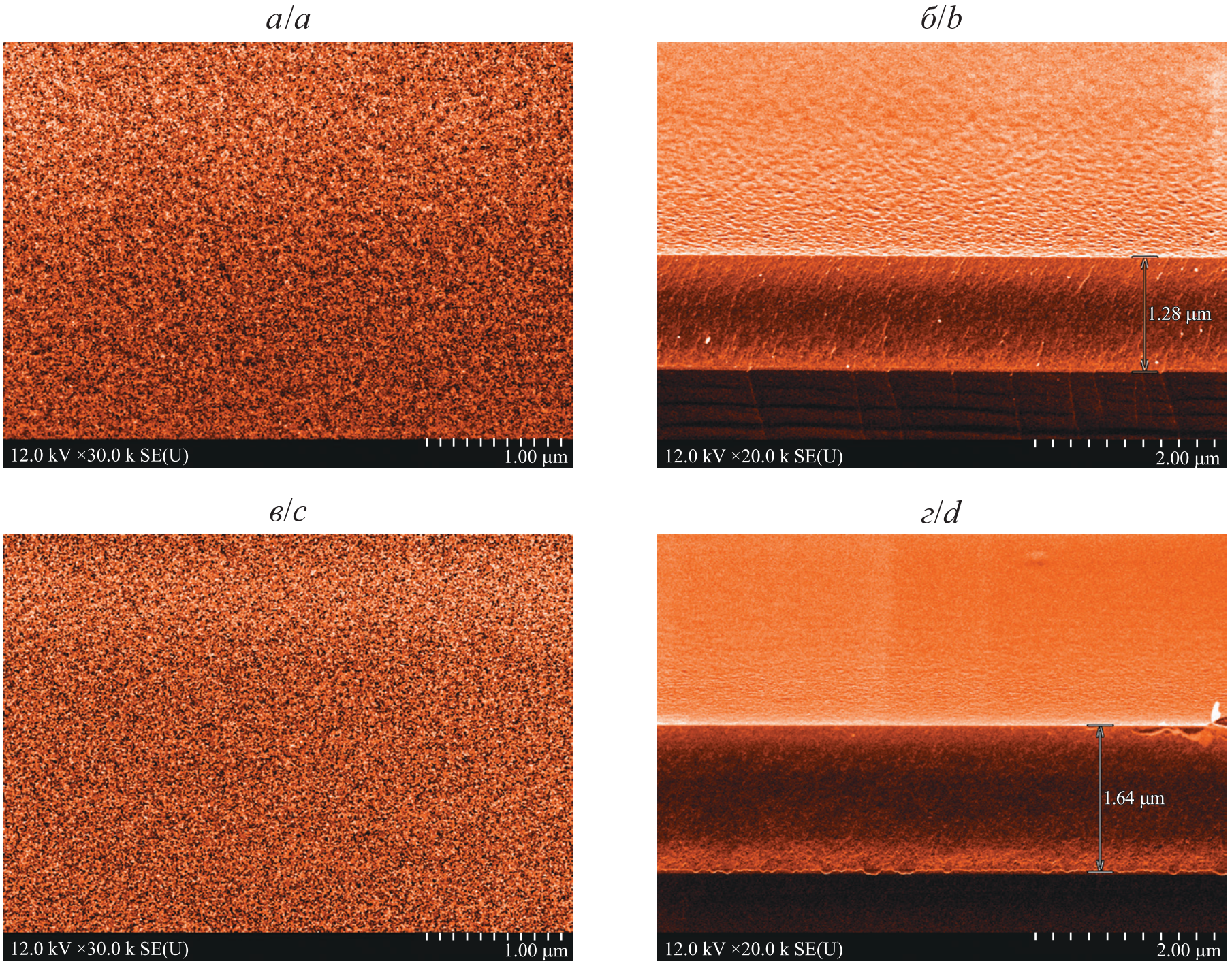

Рис. 4. СЭМ-изображения поверхности (*а*, *в*) и поперечного скола (*б*, *г*) покрытий TiAlCuN и TiAlCuCN, нанесенных с использованием мишени 4 в режиме 2 (образец 4N2 на подложке из Si (*а*, *б*) и образец 4CN2 на подложке из Si (*в*, *г*) соответственно)

Fig. 4. SEM images of the surface (*a*, *c*) and cleavage (*b*, *d*) of TiAlCuN and TiAlCuCN coatings deposited using target 4 in mode 2 (sample 4N2 on Si substrate (*a*, *b*) and sample 4CN2 on Si substrate (*c*, *d*) respectively)